

Title (en)

MATERIAL FOR ALLOYING A METAL WITH VANADIUM.

Title (de)

MATERIAL ZUM LEGIEREN EINES METALLS MIT VANADIUM.

Title (fr)

MATERIAU POUR REALISER UN ALLIAGE D'UN METAL ET DE VANADIUM.

Publication

**EP 0268679 A1 19880601 (DE)**

Application

**EP 86904463 A 19860418**

Priority

SU 8600030 W 19860418

Abstract (en)

A material intended for alloying a metal with vanadium comprises a metallic component which is covered by an envelope consisting of an alloying component of the following composition, in per cent by weight: 10-24 of silicon oxide, 14-25 of vanadium oxide, 4-14 of manganese oxide, 3-10 of titanium oxide, 1-4 of chromium oxide, 3-50 of calcium oxide or/and of magnesium oxide, the balance being iron. In the said material the content of the metallic component, comprising carbon, metal and iron, is 5-95, the balance consisting of the alloying component. The material has the form of granules measuring 0.5-30.0 mm.

Abstract (fr)

Un matériau pour réaliser un alliage d'un métal et de vanadium comprend un constituant métallique recouvert d'un enrobage composé d'un constituant de production d'alliage dont la composition en pourcentage en poids est comme suit: 10-24 d'oxyde de silicium, 14-25 d'oxyde de vanadium, 4-14 d'oxyde de manganèse, 3-10 d'oxyde de titane, 1-4 d'oxyde de chrome, 3-50 d'oxyde de calcium et/ou d'oxyde de magnésium, le solde étant sous forme de fer. Dans ledit matériau, la teneur en matériau métallique contenant du carbone, du métal et du fer est de 5-95, le solde étant représenté par le constituant de production d'alliage. Le matériau se présente sous forme de granulés dont la dimension est comprise entre 0,5 et 30,0 mm.

IPC 1-7

**C22C 35/00**

IPC 8 full level

**C22C 35/00** (2006.01); **C22C 33/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**C22C 33/006** (2013.01)

Cited by

FR2694573A1; AU2008355159B2; US8795587B2; WO2009131428A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**WO 8706272 A1 19871022**; EP 0268679 A1 19880601; EP 0268679 A4 19890919; FI 875570 A0 19871217; FI 875570 A 19871217; JP S63502995 A 19881102

DOCDB simple family (application)

**SU 8600030 W 19860418**; EP 86904463 A 19860418; FI 875570 A 19871217; JP 50368086 A 19860418